


Dell EMC PowerEdge C6525

Technical Specifications Guide

注意、小心和警告

 **注:** “注意”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

Chapter 1: 技术规格	4
底座尺寸.....	4
机箱重量.....	5
处理器规格.....	5
支持的操作系统.....	5
系统电池规格.....	5
扩展卡安装原则.....	5
内存规格.....	8
驱动器规格.....	8
端口和连接器规格.....	9
USB 端口规格.....	9
显示屏端口规格.....	9
NIC 端口规格.....	9
iDRAC9 端口规格.....	9
存储规格.....	9
视频规格.....	10
环境规格.....	10
标准操作温度规格.....	10
扩展操作温度规格.....	21
微粒和气体污染规格.....	21
相对湿度规格.....	22
最大振动规格.....	22
最大撞击规格.....	22
最大海拔高度规格.....	23
工作温度降额规格.....	23
新风工作.....	23

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 底座尺寸
- 机箱重量
- 处理器规格
- 支持的操作系
- 系电池规格
- 显卡安装原
- 内存规格
- 驱动器规格
- 端口和连接器规格
- 存储规格
- 功耗规格
- 环境规格

底座尺寸

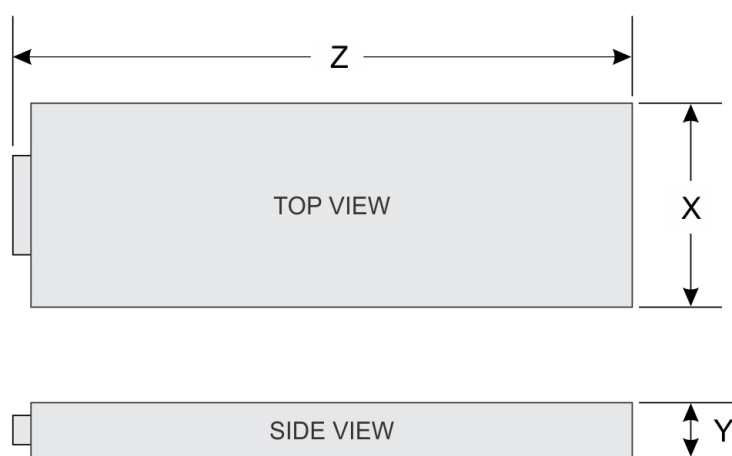


图 1: 底座尺寸

表. 1: PowerEdge C6525 底座的尺寸

X	Y	Z
174.4 毫米 (6.86 英寸)	40.1 毫米 (1.58 英寸)	570.34 毫米 (22.45 英寸)

机箱重量

表. 2: 机箱重量与底座

系统	最大重量 (包括所有底座和驱动器)
12 x 3.5 英寸配置	45.53 千克 (100.37 磅)
24 x 2.5 英寸配置	41.5 千克 (91.49 磅)
无背板的系统	35.15 千克 (77.49 磅)

处理器规格

PowerEdge C6525 底座在四个独立底座中各支持最多两个处理器。每个处理器支持多达 64 个核心。

表. 3: 处理器规格

支持的处理器	支持的处理器数量
AMD EPYC™ 7002 和 7003 系列处理器	2

支持的操作系统

PowerEdge C6525 支持以下操作系统：

- Canonical Ubuntu LTS
- Citrix XenServer
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMWare ESXi
- CentOS

 注：有关更多信息，请参考 www.dell.com/ossupport。

系统电池规格

PowerEdge C6525 底座支持 CR 2032 3.0-V 锂币系统电池。

 注：每个 PowerEdgeC6525 底座均支持一个电池。

扩展卡安装原则

下表列出了支持的扩展卡：

 **警告：**不应在企业级服务器产品中安装或使用消费者级 GPU。

PCIe 插槽优先级

表. 4: 扩展卡转接卡配置

转接卡选项	插槽 1	插槽 2	长度	高度	主处理器	最低处理器要求	支持的配置
转接卡 1A	转接卡 1A PCIe 4.0 x 16	不适用	半长	薄型	1	1	<ul style="list-style-type: none"> 12 x 3.5 英寸驱动器 24 x 2.5 英寸驱动器 8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器 无背板
转接卡 1A+2A	转接卡 1A PCIe 4.0 x 16	转接卡 2A PCIe 4.0 x 16	半长	薄型	1 和 2	2	<ul style="list-style-type: none"> 12 x 3.5 英寸驱动器 24 x 2.5 英寸驱动器 8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器 无背板
转接卡 2A	不适用	转接卡 2A PCIe 4.0 x 16	半长	薄型	2	2	<ul style="list-style-type: none"> 12 x 3.5 英寸驱动器 24 x 2.5 英寸驱动器 8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器 无背板
无转接卡	不适用	不适用	半长	薄型	不适用	1	<ul style="list-style-type: none"> 12 x 3.5 英寸驱动器 24 x 2.5 英寸驱动器 8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器 无背板

下表提供了确保充分冷却和机械配合的扩展卡安装原则。应按照所示的插槽优先级，首先安装具有最高优先级的扩展卡。必须按照插卡优先级和插槽优先级顺序安装所有其他扩展卡。

表. 5: 转接卡配置：无转接卡 - 处理器 1 和 2

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
LOM 转接卡; 1G (英特尔) (BAsE t)	3	1
LOM 转接卡; 10G (Mellanox/ Broadcom/QLogic) (BAsE t/SFP/SFP+)	3	1
LOM 转接卡; 25G (QLogic/Mellanox/ 英特尔)	3	1
BOSS S1V5 (Inventec)	4	1
卡、网络 10G (Broadcom) (BAsE t)	3	1

表. 6: 转接卡配置：转接卡 1A - 处理器 1 和 2

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
LOM 转接卡; 1G (英特尔/Broadcom) (BAsE t)	3	1
LOM 转接卡; 10G (Broadcom/QLogic) (BAsE t/SFP/SF+/SFP+)	3	1

表. 6: 转接卡配置: 转接卡 1A - 处理器 1 和 2 (续)

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
LOM 转接卡; 25G (QLogic/Mellanox)	3	1
卡、网络 1G (Broadcom/英特尔)	1	1
卡、网络 10G (Broadcom/英特尔/QLogic)	1	1
卡、网络 10G (Broadcom) (BAsE T)	3	1
卡、网络 25G (Broadcom/英特尔/QLogic/Mellanox/SolarFlare)	1	1
卡、网络 100G (Mellanox/英特尔)	1	1
GPU: Nvidia T4 16 GB	2	1
PCIe SSD (Samsung/英特尔)	1	1
PERC 10: 外部适配器 (Inventec/Foxconn)	1	1
HBA: 外部适配器 (Foxconn)	1	1
BOSS S1V5 (Inventec)	4	1
ASSY、CRD、CTL、H750、ADPT、250MM (Broadcom)	1	1
ASSY、CRD、CTL、H350、ADPT (Broadcom)	1	1
ASSY、CRD、CTL、H750、ADPT (Broadcom)	1	1

表. 7: 转接卡配置: 转接卡 1A + 转接卡 2A - 处理器 2

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
LOM 转接卡; 1G (英特尔/Broadcom) (BAsE T)	3	1
LOM 转接卡; 10G (Broadcom/QLogic) (BAsE T/SFP/SF+/SFP+)	3	1
LOM 转接卡; 25G (/QLogic/Mellanox)	3	1
卡、网络 1G (Broadcom/英特尔)	1、2	2
卡、网络 10G (Broadcom/英特尔/QLogic)	1、2	2
卡、网络 10G (Broadcom) (BAsE T)	3	1
卡、网络 25G (Broadcom/英特尔/QLogic/Mellanox/SolarFlare)	1、2	2
卡、网络 100G (Mellanox/英特尔)	1、2	2
GPU: Nvidia T4 16 GB	2	1
PCIe SSD (Samsung/英特尔)	1、2	2
PERC 10: 外部适配器 (Inventec/Foxconn)	1	1
HBA: 外部适配器 (Foxconn)	1	1
BOSS S1V5 (Inventec)	4	1
ASSY、CRD、CTL、H750、ADPT、250MM (Broadcom)	1	1

表. 7: 转接卡配置: 转接卡 1A + 转接卡 2A - 处理器 2 (续)

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
ASSY、CRD、CTL、H350、ADPT (Broadcom)	1	1
ASSY、CRD、CTL、H750、ADPT (Broadcom)	1	1

表. 8: 转接卡配置: 转接卡 2A - 处理器 2

插卡类型	插槽优先级	最大插卡数
LOM 转接卡; 1G (英特尔/Broadcom) (BAsE T)	3	1
LOM 转接卡; 10G (Broadcom/QLogic) (BAsE T/SFP/SF+/SFP+)	3	1
LOM 转接卡; 25G (QLogic/Mellanox)	3	1
卡、网络 1G (Broadcom/英特尔)	2	1
卡、网络 10G (Broadcom/英特尔/QLogic)	2	1
卡、网络 10G (Broadcom) (BAsE T)	3	1
卡、网络 25G (Broadcom/英特尔/QLogic/Mellanox/SolarFlare)	2	1
卡、网络 100G (Mellanox/英特尔)	2	1
GPU: Nvidia T4 16 GB	2	1
PCIe SSD (Samsung/英特尔)	2	1
BOSS S1V5 (Inventec)	4	1

内存规格

表. 9: 内存规格

内存模块插槽	DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量	单处理器		双处理器	
				最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
16 个 288 针	LRDIMM	八列	128 GB	128 GB	1024 GB	256 GB	2048 GB
		单列	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	RDIMM	双列	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
			32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
			64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1024 GB

驱动器规格

PowerEdge C6525 底座支持 SAS 和 SATA 硬盘以及固态硬盘 (SSD)。

表. 10: PowerEdge C6525 底座支持的驱动器选项

底座中的最大驱动器数	每个底座分配的驱动器的最大数量
12 x 3.5 英寸硬盘系统	每个底座三个 SAS 或 SATA 硬盘和 SSD
24 x 2.5 英寸非 NVMe 驱动器配置:	每个底座六个 SAS 或 SATA 硬盘和 SSD

表. 10: PowerEdge C6525 底座支持的驱动器选项 (续)

底座中的最大驱动器数	每个底座分配的驱动器的最大数量
8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器配置 (每个底座 2 个 NVMe 驱动器/每个机箱 8 个 NVMe 驱动器)	NVMe 背板支持以下配置： <ul style="list-style-type: none"> • 每个底座两个 NVMe 驱动器和四个 SAS 或 SATA 硬盘和 SSD ⓘ注: NVMe 驱动器限制为 PCIe 3.0 速度。 <ul style="list-style-type: none"> • 每个底座六个 SAS 或 SATA 硬盘和 SSD
M.2 SATA 驱动器 (可选)	M.2 SATA 卡支持的容量最高是 480 GB ⓘ注: M.2 SATA 卡可以安装到 M.2 提升板或 BOSS 卡上
用于引导的 Micro-SD 卡 (可选) (高达 64 GB)	一个在提升板 1A 上

端口和连接器规格

USB 端口规格

表. 11: PowerEdge C6525 底座 USB 端口规格

后面板
一个 USB 3.0 兼容端口

显示屏端口规格

PowerEdge C6525 底座支持一个小型显示屏端口。

NIC 端口规格

PowerEdge C6525 底座支持位于底座背面的一个 10/100/1000 Mbps 网络接口控制器 (NIC) 端口。

iDRAC9 端口规格

PowerEdge C6525 底座支持位于系统背面的一个 iDRAC9 直接端口。

存储规格

PowerEdge C6525 底座支持带有 M.2 SATA 驱动器的 RAID 选项。

表. 12: 支持的带有 M.2 SATA 驱动器的 RAID 选项

选项	单个 M.2 SATA 驱动器 (不带 RAID)	双 M.2 SATA 驱动器 (带硬件 RAID)
硬件 RAID	否	是
RAID 模式	不适用	RAID 1
支持的驱动器数量	1	2
支持的 CPU	CPU 1	CPU 1

ⓘ注: RAID 选项仅在支持两个 M.2 SATA 驱动器的 BOSS 卡上受支持。

视频规格

PowerEdge C6525 底座支持一个具有 16 MB RAM 的 Matrox G200 集成显卡。

表. 13: 支持的视频分辨率选项

解决方案	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1024 x 768	60	高达 24
1280 x 800	60	高达 24
1280 x 1024	60	高达 24
1360 x 768	60	高达 24
1440 x 900	60	高达 24
1600 x 900	60	高达 24
1600 x 1200	60	高达 24
1680 x 1050	60	高达 24
1920 x 1080	60	高达 24
1920 x 1200	60	高达 24

环境规格

下面各节包含有关系统的环境规格的信息。

注: 有关环境认证的其他信息，请参阅手册和说明文件中的“产品环境数据表”，网址：www.dell.com/poweredgemanuals。

标准操作温度规格

注:

1. 不可用：表示不由 Dell EMC 提供的配置。
2. 不受支持：表示该配置不受热支持。

注: 如果环境温度等于或小于以下表格中所列的最大连续操作温度，包括 DIMM、通信卡、M.2 SATA 和 PERC 卡在内的所有组件都受支持并具有充足的热余裕。

注: 某些系统硬件配置需要较低的温度上限。有关操作温度要求的详细信息，请联系技术支持。

表. 14: 标准操作温度规格

标准操作温度	允许工作
温度范围 (海拔高度 <900 米或 2953 英尺)	在平台上无直接光照的情况下，5°C 至 40°C (41°F 至 104°F)。
	超温受限工作 5-35°C (41-95°F) 连续操作 35-40°C (95-104°F) 10% 年度运行
湿度百分比范围	8% RH 和 -12°C 最低露点到 85% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降额	最高温度在 900 米 (2,953 英尺) 以上时按 1°C/175 米 (1.8°F/574 英尺) 降低

注: 某些配置需要一个较低的环境温度。

下表列出了根据系统中配置的 CPU 的环境温度的主要限制。下面提供的所有入口温度均以连续摄氏度为单位。

表. 15: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7513	200	32	20	20	25	25	30
7443	200	24	20	20	25	25	30
7413	180	24	20	20	25	25	30 (-2)
7313	155	16	25	25	25	25	30
7662	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7713	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7543	225	32	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7763	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7742	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7642	225	48	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7542	225	32	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7702	200	64	20	20	25	25	30
7552	200	48	20	20	25	25	30
7532	200	32	20	20	25	25	30
7502	180	32	20	20	25	25	30
7402	180	24	20	20	25	25	30
7452	155	32	25	25	25	25	30
7352	155	24	25	25	25	25	30
7302	155	16	25	25	25	25	30
7262	155	8	25	25	25	25	30
7282	120	16	30	30	30	35	35
7272	120	12	30	30	30	35	35
7252	120	8	30	30	30	35	35
7F72	240	24	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7F52	240	16	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7F32	180	8	20	20	25	25	30

i 注: 散热极端情况是指系统在 CPU 密集工作负载下工作。从上表中, (-2) 表示过散热极端情况的散热影响。

i 注: H745 不支持 CPU TDP ≥ 180 W。

i 注:

- OCP 卡需要 85C 光学收发器。
- 128 GB LRDIMM 和 GPU 配置需要额外的散热限制。

表. 16: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却

CPU	TDP	核心	12 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器
7513	200	32	不支持	不支持	不支持
7443	200	24	不支持	不支持	不支持

表. 16: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却 (续)

CPU	TDP	核心	12 × 驱动器	8 × 驱动器	4 × 驱动器
7413	180	24	不支持	不支持	不支持
7313	155	16	不支持	不支持	不支持
7662	225	64	不支持	不支持	不支持
7713	225	64	不支持	不支持	不支持
7543	225	32	不支持	不支持	不支持
7763	280	64	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持
7742	225	64	不支持	不支持	不支持
7642	225	48	不支持	不支持	不支持
7542	225	32	不支持	不支持	不支持
7702	200	64	不支持	不支持	不支持
7552	200	48	不支持	不支持	不支持
7532	200	32	不支持	不支持	不支持
7502	180	32	不支持	不支持	不支持
7402	180	24	不支持	不支持	不支持
7452	155	32	不支持	不支持	不支持
7352	155	24	不支持	不支持	不支持
7302	155	16	不支持	不支持	不支持
7262	155	8	不支持	不支持	不支持
7282	120	16	20	20	20
7272	120	12	20	20	20
7252	120	8	20	20	20
7F72	240	24	不支持	不支持	不支持
7F52	240	16	不支持	不支持	不支持
7F32	180	8	不支持	不支持	不支持

注:

- OCP 卡需要 85C 光学收发器
- 128 GB LRDIMM 和 GPU 配置需要额外的散热限制

表. 17: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 液冷

CPU	TDP	核心	24 × 驱动器	16 × 驱动器	8 × 驱动器	4 × 驱动器	无背板
7513	200	32	35	35	35	35	35
7443	200	24	35	35	35	35	35
7413	180	24	35	35	35	35	35
7313	155	16	35	35	35	35	35
7662	225	64	35	35	35	35	35
7713	225	64	35	35	35	35	35
7543	225	32	35	35	35	35	35

表. 17: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 液冷 (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7763	280	64	35	35	35	35	35
7H12	280	64	35	35	35	35	35
7742	225	64	35	35	35	35	35
7642	225	48	35	35	35	35	35
7542	225	32	35	35	35	35	35
7702	200	64	35	35	35	35	35
7552	200	48	35	35	35	35	35
7532	200	32	35	35	35	35	35
7502	180	32	35	35	35	35	35
7402	180	24	35	35	35	35	35
7452	155	32	35	35	35	35	35
7352	155	24	35	35	35	35	35
7302	155	16	35	35	35	35	35
7262	155	8	35	35	35	35	35
7282	120	16	35	35	35	35	35
7272	120	12	35	35	35	35	35
7252	120	8	35	35	35	35	35
7F72	240	24	35	35	35	35	35
7F52	240	16	35	35	35	35	35
7F32	180	8	35	35	35	35	35

表. 18: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷

CPU	TDP	核心	12 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器
7513	200	32	35	35	35
7443	200	24	35	35	35
7413	180	24	35	35	35
7313	155	16	35	35	35
7662	225	64	35	35	35
7713	225	64	35	35	35
7543	225	32	35	35	35
7763	280	64	35	35	35
7H12	280	64	35	35	35
7742	225	64	35	35	35
7642	225	48	35	35	35
7542	225	32	35	35	35
7702	200	64	35	35	35
7552	200	48	35	35	35
7532	200	32	35	35	35

表. 18: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷 (续)

CPU	TDP	核心	12 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器
7502	180	32	35	35	35
7402	180	24	35	35	35
7452	155	32	35	35	35
7352	155	24	35	35	35
7302	155	16	35	35	35
7262	155	8	35	35	35
7282	120	16	35	35	35
7272	120	12	35	35	35
7252	120	8	35	35	35
7F72	240	24	35	35	35
7F52	240	16	35	35	35
7F32	180	8	35	35	35

 注: 128 GB LRDIMM 和 GPU 配置需要额外的散热限制

表. 19: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7713P	225	64	30	30	30	35	35
7513	200	32	35	35	35	35	35
7543P	225	32	30	30	30	35	35
7443	200	24	35	35	35	35	35
7443P	200	24	35	35	35	35	35
7313P	155	16	35	35	35	35	35
7413	180	24	35	35	35	35	35
7313	155	16	35	35	35	35	35
7662	225	64	30	30	30	35	35
7713	225	64	30	30	30	35	35
7543	225	32	30	30	30	35	35
7763	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7742	225	64	30	30	30	35	35
7642	225	48	30	30	30	35	35
7542	225	32	30	30	30	35	35
7702	200	64	35	35	35	35	35
7702P	200	64	35	35	35	35	35
7552	200	48	35	35	35	35	35
7532	200	32	35	35	35	35	35
7502	180	32	35	35	35	35	35

表. 19: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却 (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7502P	180	32	35	35	35	35	35
7402	180	24	35	35	35	35	35
7402P	180	24	35	35	35	35	35
7452	155	32	35	35	35	35	35
7352	155	24	35	35	35	35	35
7302	155	16	35	35	35	35	35
7302P	155	16	35	35	35	35	35
7262	155	8	35	35	35	35	35
7282	120	16	35	35	35	35	35
7272	120	12	35	35	35	35	35
7252	120	8	35	35	35	35	35
7232P	120	12	35	35	35	35	35
7F72	240	24	30	30	30	35	35
7F52	240	16	30	30	30	35	35
7F32	180	8	35	35	35	35	35

 注: 128 GB LRDIMM 和 GPU 配置需要额外的散热限制

表. 20: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却

CPU	TDP	核心	12 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器
7713P	225	64	20	25	25
7513	200	32	25	35	35
7543P	225	32	20	25	25
7443	200	24	25	35	35
7443P	200	24	25	35	35
7313P	155	16	30	35	35
7413	180	24	25	35	35
7313	155	16	30	35	35
7662	225	64	20	25	25
7713	225	64	20	25	25
7543	225	32	20	25	25
7763	280	64	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持
7742	225	64	20	25	25
7642	225	48	20	25	25
7542	225	32	20	25	25
7702	200	64	25	35	35
7702P	200	64	25	35	35

表. 20: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却 (续)

CPU	TDP	核心	12 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器
7552	200	48	25	35	35
7532	200	32	25	35	35
7502	180	32	25	35	35
7502P	180	32	25	35	35
7402	180	24	25	35	35
7402P	180	24	25	35	35
7452	155	32	30	35	35
7352	155	24	30	35	35
7302	155	16	30	35	35
7302P	155	16	30	35	35
7262	155	8	30	35	35
7282	120	16	35	35	35
7272	120	12	35	35	35
7252	120	8	35	35	35
7232P	120	12	35	35	35
7F72	240	24	20	25	25
7F52	240	16	20	25	25
7F32	180	8	25	35	35

280 W CPU 的其他散热限制

- 128 GB LRDIMM 不受支持。
- 限制已启用 GPU 的 280 W CPU。
- 不支持 PSU 冗余模式 (1+1)。
- 支持 PSU 非冗余模式 (2+0) 配置模式。

T4 GPU 卡限制

表. 21: 带 1 个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的双处理器的最大连续操作温度 (空气冷却)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7513	200	32	不支持				25
7443	200	24	不支持				25
7413	180	24	不支持				25
7313	155	16	不支持				25
7662	225	64	不支持				
7713	225	64	不支持				
7543	225	32	不支持				
7763	280	64	不支持				
7H12	280	64	不支持				

表. 21: 带 1 个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的双处理器的最大连续操作温度 (空气冷却) (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7F72	240	24	不支持				
7F52	240	16	不支持				
7742	225	64	不支持				
7642	225	48					
7542	225	32					
7702	200	64	不支持				25
7552	200	48					
7532	200	32					
7502	180	32					
7402	180	24					
7F32	180	8					
7452	155	32					
7352	155	24					
7302	155	16					
7262	155	8					
7282	120	16	不支持		25	25	30
7272	120	12			25	25	30
7252	120	8			25	25	30

注:

- 3.5" 机箱 (空气冷却) 不支持 GPU 卡。
- 128 GB LRDIMM 不受支持。
- 支持 1 个 GPU 卡 + OCP 卡。插槽 #2 对于 T4 GPU 是第一优先级。
- 支持 1 个 GPU 卡 + PCIe 卡。插槽 #2 对于 T4 GPU 是第一优先级。

表. 22: 带 1 个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的双处理器的最大连续操作温度 (液体冷却)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7513	200	32	30	30	30	30	30
7443	200	24	30	30	30	30	30
7413	180	24	30	30	30	30	30
7313	155	16	30	30	30	30	30
7662	225	64	30	30	30	30	30
7713	225	64	30	30	30	30	30
7543	225	32	30	30	30	30	30
7763	280	64	30	30	30	30	30
7H12	280	64	30	30	30	30	30
7F72	240	24	30	30	30	30	30
7F52	240	16	30	30	30	30	30

表. 22: 带 1 个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的双处理器的最大连续操作温度 (液体冷却) (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7742	225	64	30	30	30	30	30
7642	225	48	30	30	30	30	30
7542	225	32	30	30	30	30	30
7702	200	64	30	30	30	30	30
7532	200	32	30	30	30	30	30
7502	180	32	30	30	30	30	30
7402	180	24	30	30	30	30	30
7F32	180	8	30	30	30	30	30
7452	155	32	30	30	30	30	30
7352	155	24	30	30	30	30	30
7302	155	16	30	30	30	30	30
7262	155	8	30	30	30	30	30
7282	120	16	30	30	30	30	30
7272	120	12	30	30	30	30	30
7252	120	8	30	30	30	30	30

注:

- 128 GB LRDIMM 不受支持。
- 不支持 3.5" 机箱

表. 23: 带一个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的单处理器的最大连续工作温度 (空气冷却)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7713P	225	64	20	20	20	20	25
7513	200	32	20	25	25	25	30
7543P	225	32	20	20	20	20	25
7443	200	24	20	25	25	25	30
7443P	200	24	20	25	25	25	30
7313P	155	16	20	25	25	25	35
7413	180	24	20	25	25	25	30
7313	155	16	20	25	25	25	35
7662	225	64	20	20	20	20	25
7713	225	64	20	20	20	20	25
7543	225	32	20	20	20	20	25
7763	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7F72	240	24	20	20	20	20	25
7F52	240	16	20	20	20	20	25
7742	225	64	20	20	20	20	25

表. 23: 带一个用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 T4 GPU 卡的单处理器的最大连续工作温度 (空气冷却) (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7642	225	48	20	20	20	20	25
7542	225	32	20	20	20	20	25
7702	200	64	20	25	25	25	30
7702P	200	64	20	25	25	25	30
7532	200	32	20	25	25	25	30
7502	180	32	20	25	25	25	30
7502P	180	32	20	25	25	25	30
7402	180	24	20	25	25	25	30
7402P	180	24	20	25	25	25	30
7452	155	32	20	25	25	25	35
7352	155	24	20	25	25	25	35
7302	155	16	20	25	25	25	35
7302P	155	16	20	25	25	25	35
7262	155	8	20	25	25	25	35
7282	120	16	25	25	25	30	35
7272	120	12	25	25	25	30	35
7252	120	8	25	25	25	30	35
7232P	120	12	25	25	25	30	35

注:

- 3.5" 机箱 (空气冷却) 不支持 GPU 卡。
- 128 GB LRDIMM 不受支持。
- 支持 OCP 卡。

表. 24: 带用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 128 GB LRDIMM 的双处理器的最大连续操作温度 (空气冷却)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7513	200	32	20	20	25	25	25
7443	200	24	20	20	25	25	25
7413	180	24	20	20	25	25	25
7313	155	16	20	20	25	25	30
7662	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7713	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7543	225	32	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7763	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7H12	280	64	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7742	225	64	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7642	225	48	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7542	225	32	不支持	不支持	不支持	不支持	20

表. 24: 带用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 128 GB LRDIMM 的双处理器的最大连续操作温度 (空气冷却) (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7702	200	64	20	20	25	25	25
7532	200	32	20	20	25	25	25
7502	180	32	20	20	25	25	25
7402	180	24	20	20	25	25	25
7452	155	32	20	20	25	25	30
7352	155	24	20	20	25	25	30
7302	155	16	20	20	25	25	30
7262	155	8	20	20	25	25	30
7F72	240	24	不支持	不支持	不支持	不支持	20
7F52	240	16	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
7282	120	16	20	20	25	30	30
7272	120	12	20	20	25	30	30
7252	120	8	20	20	25	30	30

注: H745 不支持 CPU TDP \geq 180 W。

注:

- 3.5" 机箱不支持 128 GB LRDIMM。
- 128 GB LRDIMM 不支持 T4 GPU 卡。

表. 25: 带用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 128 GB LRDIMM 的双处理器的最大连续操作温度 (液体冷却)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7513	200	32	30	30	30	30	30
7443	200	24	30	30	30	30	30
7413	180	24	30	30	30	30	30
7313	155	16	30	30	30	30	30
7662	225	64	30	30	30	30	30
7713	225	64	30	30	30	30	30
7543	225	32	30	30	30	30	30
7763	280	64	30	30	30	30	30
7H12	280	64	30	30	30	30	30
7F72	240	24	30	30	30	30	30
7F52	240	16	30	30	30	30	30
7742	225	64	30	30	30	30	30
7642	225	48	30	30	30	30	30
7542	225	32	30	30	30	30	30
7702	200	64	30	30	30	30	30
7532	200	32	30	30	30	30	30

表. 25: 带用于 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的 128 GB LRDIMM 的双处理器的最大连续操作温度 (液体冷却) (续)

CPU	TDP	核心	24 x 驱动器	16 x 驱动器	8 x 驱动器	4 x 驱动器	无背板
7502	180	32	30	30	30	30	30
7402	180	24	30	30	30	30	30
7F32	180	8	30	30	30	30	30
7452	155	32	30	30	30	30	30
7352	155	24	30	30	30	30	30
7302	155	16	30	30	30	30	30
7262	155	8	30	30	30	30	30
7282	120	16	30	30	30	30	30
7272	120	12	30	30	30	30	30
7252	120	8	30	30	30	30	30

注:

- 128 GB LRDIMM 不支持 T4 GPU 卡。
- 3.5" 机箱不支持 128 GB LRDIMM。

扩展操作温度规格

表. 26: 扩展操作温度

扩展操作温度	允许工作
温度范围 (海拔高度 <900 米或 2953 英尺)	在平台上无直接光照的情况下, 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)。
	超温受限工作 5-35°C (41-95°F) 连续工作 35-40°C (95-104°F) 10% 年度运行时 40-45°C (104-113°F) 1% 年度运行时
湿度百分比范围	8% RH 和 -12°C 最低露点到 90% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降额	最高温度在 900 米 (2,953 英尺) 以上时按 1°C/125 米 (1.8°F/410 英尺) 降低

注: 在扩展温度范围下操作时, 系统性能将会受到影响。

注: 在扩展温度范围下操作时, 系统事件日志中可能会有环境温度警告。

微粒和气体污染规格

表. 27: 微粒污染规格

微粒污染	规格
空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。
注:	此情况仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外 (诸如办公室或工厂车间等环境) 使用的 IT 设备。
注:	进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。
导电灰尘	空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。

表. 27: 微粒污染规格 (续)

微粒污染	规格
<p>注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。</p>	
腐蚀性灰尘	空气中不得含有腐蚀性灰尘。
<p>空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。</p>	
<p>注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。</p>	

表. 28: 气体污染规格

气体污染	规格
铜片腐蚀率	<300 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的 G1 类标准
银片腐蚀率	<200 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的 G1 类标准
<p>注: 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量。</p>	

相对湿度规格

表. 29: 相对湿度规格

相对湿度	允许工作
温度范围 (海拔高度 ≤900 米或 2953 英尺)	在平台上无直接光照的情况下, 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)。
湿度百分比范围	8% RH 和 -12°C 最低露点到 80% RH 和 21°C (69.8°F) 最大露点
工作海拔高度降额	最高温度在 900 米 (2,953 英尺) 以上时按 1°C/300 米 (1.8°F/984 英尺) 降低

最大振动规格

表. 30: 最大振动规格

最大振动	规格
运行时	5 Hz 至 350 Hz 时, 0.26 Grms (所有操作方向)。
存储	10 Hz 至 500 Hz 时 1.88 Grms, 可持续 15 分钟 (测试所有六面)。

最大撞击规格

表. 31: 最大撞击规格

最大撞击	规格
运行时	在正向和负向 x、y、z 轴连续执行了六个 6 G 撞击脉冲, 持续时间长达 11 毫秒 (系统每侧各四个脉冲)。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

最大海拔高度规格

表. 32: 最大海拔高度规格

最大海拔高度	允许工作
最大温度梯度 (适用于工作时和非工作时)	20°C (一小时) * (36°F [一小时]) 和 5°C (15 分钟) (9°F [15 分钟])、5°C (一小时) * (9°F [一小时]) - 针对磁带硬件
非工作温度限制	-40 至 65°C (-40 至 149°F)
非工作湿度限制	最大露点为 27°C (80.6°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%。空气必须始终非冷凝。
最大非工作海拔高度	12000 米 (39370 英尺)
最大工作海拔高度	3,048 米 (10,000 英尺)

工作温度降额规格

工作温度降额规格

表. 33: 工作温度降额规格

工作温度降额	规格
< 35°C (95°F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1°C/300 米 (1°F/547 英尺) 降低。
35°C-40°C (95°F-104°F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1°C/175 米 (1°F/319 英尺) 降低。
> 45°C (113°F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1°C/125 米 (1°F/228 英尺) 降低。

新风工作

表. 34: 新风工作限制

液冷	空气冷却
<ul style="list-style-type: none">不支持 NVMe SSD。不支持 LRDIMM。不支持大于 25 W 的 PCIe 卡。GPU 卡不受支持。不支持 3.5 英寸驱动器配置。	<ul style="list-style-type: none">不支持 NVMe SSD。不支持 LRDIMM。不支持大于 25 W 的 PCIe 卡。GPU 卡不受支持。不支持 3.5 英寸驱动器配置。2.5 英寸无背板配置仅支持最大 200 W 的 TDP 处理器。仅支持单处理器配置。不支持双处理器配置。